

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于东莞优邦材料科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之

上市保荐书

保荐人



申万宏源证券承销保荐有限责任公司
SHENWAN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO.,LTD

二〇二六年八月

深圳证券交易所：

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐人”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第2号——上市保荐书内容与格式》等法律法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）基本资料

- 1、公司名称：东莞优邦材料科技股份有限公司
- 2、英文名称：U-BOND Technology Inc.
- 3、注册资本：8,000.00 万元
- 4、注册地：广东省东莞市大岭山镇大塘沿河街 1 号 1 栋 101 室
- 5、注册时间：2003 年 9 月 26 日
- 6、法定代表人：郑建中
- 7、联系方式：0769-85609382
- 8、负责信息披露和投资者关系的部门：证券部
- 9、负责信息披露和投资者关系的负责人：李相兴
- 10、电话：0769-85609380

（二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平

1、发行人主营业务情况

公司是一家主营电子装联材料及配套自动化设备的研发、生产与销售的高新技术企业，主要包括电子胶粘剂、电子焊接材料、湿化学品、自动化设备等四大业务板块，为客户提供焊接、粘接、表面处理等电子装联解决方案，产品最终广泛应用于智能终端、通信、新能源、半导体等领域。

公司是国内电子装联材料领先企业之一，自设立以来始终深耕电子装联材料行业，通过持续的技术研发、经验积累和市场开拓，公司建立了丰富的产品矩阵、完善的生产、研发和销售服务体系，形成了良好的行业口碑。公司与富士康、台达集团、和硕集团、群光电能、奇宏科技、明纬电子、立讯精密、亿纬锂能等行业知名企业建立了稳定的合作关系，产品最终服务于索尼、惠普、戴尔、亚马逊、中兴通讯、小鹏汽车等国内外知名终端品牌客户。公司以有机硅胶、锡膏为代表的多款产品性能及可靠性获得相应领域知名客户的认可并进入其供应链体系，正逐步推动类似产品国产化进程。

2、发行人核心技术和研发水平

(1) 发行人的核心技术

公司通过自主研发，掌握了关键原料设计合成技术、配方设计及生产工艺控制技术、特种工艺设备设计技术、产品检测及验证技术等核心技术，核心技术先进性及具体表征如下：

序号	技术种类	技术名称	技术先进性及具体表征
1	关键原料设计合成技术	官能化硅油设计及合成技术	公司具备设计及合成各类端烷氧基硅油、多官能乙烯基硅油、官能化含氢硅油、表面处理用单端硅油、以及苯基硅树脂合成能力，并能够将生产的硅油中的低分子硅氧烷挥发性物质含量控制在较低水平。
		催化剂合成技术	公司具备自主多种合成铂金催化剂和钛酸酯催化剂的能力，其中铂络合物采用混用络合物搭配，大幅度提高了应用稳定性。
		填料粒径控制与表面处理技术	公司在填料的表面处理、阻燃性、导热性、填料粒径控制等方面具备技术积累，可实现高填充率，开发的产品能够实现高导热、低热阻特性以及良好的阻燃特性。
		丙烯酸酯胶关键原料合成技术	公司根据丙烯酸酯胶产品开发设计要求，设计不同类型的光固化和湿气固化的化学分子结构，合成所需的一系列丙烯酸酯中间体。
		微细低氧球形锡粉精密制备技术	公司拥有关键的微细低氧球形锡粉精密制备技术，分别是高速离心雾化和高频超声振动雾化技术，将合金液体雾化成微细液滴冷却后形成粉末，成功实现了高性能锡粉的规模化、高质量生产。公司进一步整合气力分级技术、氮气循环技术和超声波筛分技术，有效解决传统锡粉制备过程中存在的球形度低、氧含量高、粒度分布宽等难题。所制备的微细锡粉不仅具有高球形度，还兼备低氧含量的优异特性，为生产高质量的锡膏提供了坚实的核心原材料基础。
2	配方设计及生产工艺控制技术	电子胶粘剂导热特性提升技术	公司高导热丙烯酸酯胶产品，以球形导热填料、石墨烯或碳纳米管为填料，配合特种丙烯酸树脂及功能助剂，通过底部涂覆高效粘接促进剂，在此基础上涂覆高导热胶粘剂的方式，既实现了导热的功能，也能实现散热器与发热元件的粘接固定。用导热胶取代导热垫片，用底部涂覆粘接胶取代螺丝固定，形成了全新的散热模组架构。
		有机硅胶配方技术	公司具备新型有机硅披覆胶产品配方技术，公司深入研究有机硅的表面能、热稳定性、绝缘特性等，采用聚有机硅氧烷及苯基硅树脂作为主材料，通过分子层面的设计、合成含软硬段结构的嵌段聚合物，形成韧性高硬度的涂层，以满足线路板及电子器件的防护性能要求。制备后的披覆胶具有可调的表干/固化速度，优异的电学性能，优秀的耐高温高湿、盐雾和霉菌性能、良好的施工性、存储条件温和、对常用电子基材具有较高的粘附力以及适当的可返修性。 公司具备脱醇型单组份室温硫化硅橡胶产品配方技术，

序号	技术种类	技术名称	技术先进性及具体表征
			采用控制低分子硅氧烷挥发物质含量的封端硅油制备，具有快速固化，储存稳定性好，耐候性好，功能性强等特点，广泛用于智能终端和新能源等领域。 公司具备完整的低热阻导热界面材料技术和控制能力，公司拥有填料粒径精细分级技术及烷氧基单端硅油做填料表面处理核心技术，可实现低热阻、高导热、低粘度等特性，用于各种高端导热界面材料如导热硅脂、灌封胶、硅凝胶、粘接胶等产品，在通信、智能终端、半导体领域得到广泛应用。 公司具备低密度导热硅凝胶配方技术，能够实现高导热轻量化要求，应用于新能源领域。
		环氧胶配方技术	公司环氧胶配方基于酸酐、硫醇、咪唑体系和改性胺配方体系，具有固化快、粘接强度高、耐高温高湿度等特点，满足客户对生产工艺和可靠性的要求。 公司在器件级环氧底部填充胶领域实现重要技术突破，产品具有极低的热膨胀系数，较强的焊后耐受性，超低α射线释放特性以及极低的离子残留水平，显著提高芯片封装器件的可靠性和使用寿命，适用于高端微电子封装应用场景。
		丙烯酸酯胶配方技术	公司具备丙烯酸酯胶产品配方设计技术，应用自主合成的官能化丙烯酸酯中间体，可实现多重固化，产品具有粘接强度高、韧性好和可靠性好等特点。广泛应用于电子器件的绝缘保护、粘接等。
		低温无铅锡膏配方技术	公司锡铋系低温无铅锡膏目前主要应用于两大领域，分别为“风冷散热模组”和“低温 SMT 组装/封装”。在风冷散热模组应用方面，通过独特配方设计攻克 Cu-Ni 焊接界面在低温条件下的焊接技术难点，形成“复合有机酸-有机胺”活性体系技术，能够在低于 175°C 的焊接温度下高效还原 Bi_2O_3、NiO 等难以还原的金属氧化物，显著提高焊接质量，铜基材铺展率不低于 85%，镍基材铺展率超过 75%，焊接界面空洞率低，结合强度高，热阻小，显著提升了散热模组的可靠性与导热效率。 在低温 SMT 组装/封装应用中，针对 SMT 工艺要求，开发出“复合高软化点松香体系+复合有机酸与长链咪唑活性体系+中高沸点醇醚溶剂体系”的综合配方。其焊点成型佳、组装空洞率低，焊后残留物具有高表面绝缘电阻，适配混装制程，有效避免热撕裂等缺陷，大幅提高 PCBA 组装良率和产品长期可靠性。该系列应用的 DW-1000 低温无铅锡膏已成功列入 Intel MAS 认证清单并稳定交易 6 年以上，成为全球少数可批量投入实际 SMT 低温组装应用的锡膏产品之一。
		高温无铅锡膏配方技术	公司锡膏助焊剂配方中涵盖松香体系、活性剂体系、溶剂体系、触变剂体系、缓蚀剂体系及抗氧剂体系等全面的材料特性数据库，为高性能焊料的开发与选型提供了系统化的数据支撑。针对高温焊接工艺的严苛要求，创新性采用“复合耐热松香体系+复合梯度活化体系”协同设计。复合松香体系通过酸改性松香与氢化松香/氢化松香酯的合理复配，结合分子链段长度的精细化调

序号	技术种类	技术名称	技术先进性及具体表征
			控, 显著提高体系的热稳定性和抗氧化能力; 复合梯度活化体系则整合了低温、中温与耐高温的长链有机酸/咪唑类化合物, 实现活化温度窗口与 SAC 系合金从熔融到焊点凝固全过程的精确匹配, 有效避免因活化剂过早挥发或高温失效所导致的焊接缺陷。公司 EUP-1000HQR 和 EUP-2000 SAC305 锡膏已列入 Intel NG3.0 SAC 锡膏 MAS。
		焊料合金体系设计技术	公司建立并维护电子焊接材料各金属元素对焊料合金性能之间关联关系 Know-how 数据库, 涵盖合金抗氧化体系、合金耐热疲劳体系、合金润湿性体系、焊点合金强度体系。通过多元微合金化的精准配比与结构设计, 采用“主元-辅元-微合金元”三级协同架构, 系统运用析出强化、固溶强化、金属间化合物界面反应抑制以及晶粒粗大抑制等先进技术手段, 有效克服了传统锡基焊料在高可靠性应用场景中存在的性能瓶颈, 实现了焊料合金在极端条件下的高可靠性与稳定性。基于该技术, 公司已成功开发出列入 Intel 白皮书推荐的消费电子低温焊接制程合金、耐热疲劳特性的高可靠合金、钢系中温无铅合金等。
		应用于超低离地间隙及窄植球间距类先进封装的碱性清洗配方技术	产品设计碱性产品体系, 设计上采用高分解力、适度极性和适度氢键结合, 能快速去除细小间隙中的助焊剂残留物, 可适用于包括 2.5D/3D TSV 堆叠、BGA、SiP 等封装制程清洗, 清洗微细间距间的各类水洗型及部分免洗型锡膏、助焊剂型残留, 同时温和配方, 可兼容铝材治具的清洗线, 也使清洗后的焊点和焊盘有光泽。
		半导体封装的水基 PH 中性清洗配方技术	PH 中性技术使清洗剂拥有优异的材料兼容性, 也在材料兼容性方面克服了多数碱性清洗剂难以解决的难题, 避免缓蚀与助焊剂残留以及环境发生作用后的缓蚀作用受限问题, 同时也降低了吸附型缓蚀剂吸附在金属表面和底部元件上, 不易漂洗去除, 带来的区域电阻力变化和不可预测的失效风险。 中性清洗产品不仅对器件上的典型金属材料(包括敏感金属)拥有良好的材料兼容性, 同时对包括油墨、电阻包胶、设备管道以及工装设备上的塑胶、标识等均有良好兼容, 可以延长设备配件使用寿命。
		环保中性无氮无磷封装清洗配方技术	在水基 PH 中性清洗技术的基础上, 材料升级, 突破市面清洗剂多利用含氮有机碱为材料进行皂化清洗的用料, 通过无机皂化反应物, 减少封装清洗剂中氮元素的产生, 采用多元嵌段聚醚类来替代含磷类活性剂, 同样达到超低表面张力的效果, 满足超低离地间隙及窄植球间距上的残留清洗, 无氮无磷的产品设计, 大大降低了清洗后废液处理成本, 也从根源上彻底避免氮磷元素对水体生态环境带来的污染危害。
		无水工艺溶剂型免漂洗清洗配方技术	采用环保创新型溶剂, 针对助焊剂残留特定污染物能有效清洗微细间隙或复杂结构的残留, 尤其适用于敏感器件(pH 值敏感、水敏感)等器件清洗, 该技术免去水漂洗步骤及相关用水、废水处理; 部分工艺可实现溶剂循环利用, 降低消耗和成本。

序号	技术种类	技术名称	技术先进性及具体表征
3	特种工艺设备设计技术	精密 BGA 锡球生产设备设计技术	公司拥有先进的精密 BGA 锡球生产设备设计技术，涵盖多个关键创新点，以确保高效、高质量的生产过程。基于“均匀液滴喷射成型”射球技术，可实现直径小于 1.5mm 的精密锡球生产：集成温度、压力、振动、电压多场耦合协同调控系统，实时优化液滴凝固环境，显著提升成型稳定性和一致性；采用高频脉冲射流技术，实现真球成球率超过 95%。 锡球有机酸蒸镀表面处理技术：通过有机酸纳米级厚度均匀涂覆工艺，在锡球表面形成致密保护层，有效隔绝氧气和湿气，确保锡球在摇测 2,000 次后仍不发生氧化发黑现象，延长产品使用寿命并增强可靠性。
		脱丙酮交联剂生产设备技术	公司具备脱丙酮硅烷交联剂及配套硅烷偶联剂的合成技术，以及生产装置的自主设计能力，已完成量产的产线架设，产品不仅可满足公司脱丙酮有机硅胶粘剂体系的产量要求，也用于世界知名有机硅品牌的产品中。
4	产品检测及验证技术	工艺性能及可靠性验证测试技术	公司配备各类工艺设备和可靠性测试设备，构建了一个覆盖“材料基本特性—工艺适配性能—应用环境耐受性”的三维一体化测试矩阵，基于该体系，系统性地开展从材料基础物性到复杂工艺参数的全方位测定，并在模拟多种严苛应用环境下完成可靠性验证，从而为产品全生命周期的质量控制、客户多样化需求的精准响应以及持续技术迭代创新，提供坚实可靠的科学研究依据和数据支撑。
		化学成分、微观结构及理化性能分析检测技术	公司配备全套分析测试相关设备，配备了包括 SEM+EDS、GC-MS、RAMAN、FTIR、HPLC、STA、IC、TMA、DMA、GPC、超景深显微镜、流变仪、焊点测试仪等在内的多种关键分析设备，满足各业务板块的理化性能评测要求。公司具备分析材料的基本理化性能、化学成分、有害物质等能力，同时建立了较为完整的基础材料、配方结构、性能响应的 Know-how 数据库，可以实现性能需求、结构设计、配方实现的产品开发。

(2) 发行人的研发水平

公司组建了一支专业高效、经验丰富、具备创新意识和创造力的研发团队，截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有研发与技术人员 148 名，占员工总人数 14.35%。公司以应用于智能终端的电子装联材料起步，通过自主研发创新逐步在通信、新能源、半导体等领域实现技术突破。公司参与了 2 项国家标准和 5 项行业标准的编制起草工作。截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有已授权专利 104 项，其中发明专利 57 项。

公司获评国家级高新技术企业、广东省专精特新中小企业、东莞市创新百强企业，公司研发中心获评广东省电子胶粘剂（优邦）工程技术研究中心；子公司苏州优诺获评国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，研发中心

获评江苏省电子封装材料及可靠性工程技术研究中心；公司是深圳市终端电子制造产业协会理事单位，在 2020 年新型显示与半导体及 5G 产业最具影响力奖项年度评选中，公司荣获由中国通信工业协会颁发的“产业材料卓越创新奖”。

（三）主要经营和财务数据及指标

项目	2025.12.31 /2025 年	2024.12.31 /2024 年	2023.12.31 /2023 年
资产总额（万元）	119,764.94	104,448.99	94,007.62
归属于母公司所有者权益（万元）	84,353.52	74,771.36	69,237.61
资产负债率（母公司）	29.86%	18.95%	7.41%
营业收入（万元）	113,568.72	102,459.82	89,879.23
净利润（万元）	10,823.54	9,362.24	8,994.16
归属于母公司所有者的净利润（万元）	10,823.54	9,362.24	8,994.16
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	9,984.00	9,182.02	9,088.38
基本每股收益（元）	1.35	1.18	1.13
稀释每股收益（元）	1.35	1.18	1.13
加权平均净资产收益率	13.47%	12.64%	13.56%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	10,296.48	8,334.70	12,209.35
现金分红（万元）	1,600.00	5,181.25	1,587.50
研发投入占营业收入的比例	4.48%	4.29%	4.15%

（四）发行人存在的主要风险

1、市场竞争加剧和产品被替代的风险

从国内电子装联材料市场竞争格局来看，包括电子胶粘剂、电子焊接材料和湿化学品等细分行业均呈现外资企业主导高端市场、本土企业把控中低端市场的竞争格局。目前电子装联材料行业在技术壁垒较低、产品同质化严重的低端市场竞争激烈，公司基于差异化战略定位，主要产品聚焦于智能终端、通信、新能源、半导体等中高端应用领域，受益于下游市场良好发展、供应链加速国产替代，未呈现明显竞争加剧态势。但随着国产化进程的深入，不可避免地与大型跨国公司如德国汉高、美国爱法、日本千住等在中高端市场和新的应用领域形成竞争。跨国公司享有很高的市场声望及地位，拥有丰富的案例解决经验，产品更为全面，工艺较为先进，这些优势增加了本土企业国产化进程的难度，公司亦可能面临着未来国内外市场更加激烈的市场竞争风险。同时，随着国内头部企业持续加大研

发投入并在产品技术上取得突破，正加速向中高端核心领域渗透，公司与国内同行业公司头部客户导入及市场份额争夺上的竞争与替代风险亦将逐步显现。

因此，若公司不能紧跟市场发展趋势，在人才储备、技术研发、产品性能、客户服务等方面进一步增强实力，特别是在下游供应链中的技术迭代与综合配套能力不及预期，导致高端应用领域的市场开拓受阻，或面临国内外竞争对手的市场挤压，则公司将可能面临市场竞争加剧、市场份额被挤占、产品被替代的风险。同时，公司下游应用领域广泛，客户需求多样，若未来因未能持续满足下游客户需求，或市场竞争环境发生超预期变化，也可能对公司的市场地位产生不利影响，进而对业绩增长产生不利影响。

2、经营业绩下滑的风险

报告期内，公司实现营业收入金额分别为 89,879.23 万元、102,459.82 万元、113,568.72 万元，2024 年、2025 年分别同比增长 14.00%、10.84%，保持持续增长态势，但增速有所放缓。

公司电子胶粘剂、电子焊接材料、湿化学品、自动化设备业务在经营模式、成本结构、客户结构、下游需求驱动因素等方面存在差异，各业务面临的经营风险亦有所不同。公司产品主要应用于智能终端、通信、新能源、半导体等领域，下游市场需求受全球宏观经济、国际贸易环境、终端消费需求、产业投资周期、技术迭代进展等因素综合影响。若未来宏观经济增速放缓、国际贸易摩擦加剧，或消费电子、服务器、半导体、新能源及储能等下游行业景气度下降，可能导致客户采购需求减少，并对公司整体经营业绩产生不利影响。

电子胶粘剂业务主要受消费电子终端需求、新能源汽车及储能等下游行业发展、客户及产品结构变化影响。报告期内，公司电子胶粘剂收入基本保持稳定，新能源领域销售占比有所提升。不同应用领域产品在销售规模、价格及盈利水平方面存在差异，若消费电子需求下降、新能源行业增速放缓，或新产品、新客户导入未达预期，电子胶粘剂业务存在业绩下降的风险。

电子焊接材料业务直接材料成本占比超过 90%，且材料成本以锡锭、银等金属原材料为主，产品售价及盈利水平与大宗金属价格具有较强相关性。报告期内，公司电子焊接材料收入持续增长，但若未来锡锭、银等原材料价格大幅波

动，而产品售价调整滞后，可能导致毛利率下降；同时，若消费电子、服务器、半导体、通信、新能源及储能等下游需求下降，可能导致销量减少，电子焊接材料业务存在业绩下降的风险。

湿化学品业务收入主要集中于智能终端领域，且对富士康销售集中度较高。智能终端等核心下游行业具有材料创新快、工艺更迭频繁的特征，湿化学品业务需求除受消费电子行业景气度影响外，还受到终端产品材料路线、结构设计、加工工艺变化影响。2025 年湿化学品收入同比大幅下降，主要系富士康代工终端产品材质转换导致金属表面处理剂销量减少所致，终端产品材料变化亦会导致公司产品下游需求出现阶段性波动。公司对富士康的产品导入及供应份额正常，但若未来终端产品发生材质或工艺变化、公司产品无法持续满足客户需求、无法持续保持产品竞争力、无法紧跟工艺演进趋势进行技术研发并及时推出匹配的高附加值产品，亦或富士康采购需求下降、其他客户和应用领域业务拓展不及预期等，湿化学品业务存在业绩继续下降的风险。

自动化设备业务具有定制化、订单驱动和验收周期较长等特点，订单获取主要受消费电子等下游行业景气度、客户资本开支、新增产线建设、设备更新周期及技术升级节奏影响，各期订单及收入可能存在较大波动。若未来下游市场景气度下降、客户缩减资本性开支、设备更新需求放缓等，公司未能持续获取订单或中标率下降，自动化设备业务存在业绩下降的风险。

综上，若上述不利因素单独或叠加发生，公司部分业务可能出现收入、盈利水平下降，并可能导致公司整体经营业绩增速放缓甚至下滑。

3、客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五大客户相对稳定，合计销售收入占主营业务收入比例分别为 53.86%、49.12%、45.07%，其中第一大客户富士康销售收入占主营业务收入比例超过 20%，公司客户集中度相对较高，存在销售客户集中、对富士康销售占比较高的风险。

报告期内，公司主要客户以国内外一线品牌客户及其供应链企业为主，客户集中度较高符合下游行业特点，公司与主要客户合作关系稳定，主要客户行业地位突出且经营状况良好，交易具有持续性，同时公司持续将产品下游应用

领域由智能终端拓宽至新能源、通信、半导体等不同行业，新客户开发和新应用领域业务拓展取得良好进展。但如果未来公司与下游市场主要客户合作出现不利变化、新客户拓展进度不如预期，或公司主要客户因行业竞争加剧、宏观经济波动等原因导致市场份额下降、经营状况出现不利变化，可能导致主要客户减少对公司产品的采购需求、公司与客户合作稳定性和业务持续性受到挑战，从而对公司的业务发展带来不利影响，影响公司持续经营能力。

4、对富士康销售稳定性的风险

报告期内，富士康为公司第一大客户，公司对富士康销售收入占主营业务收入的比例分别为 34.87%、31.78%、26.55%，销售毛利占公司主营业务毛利的比例分别为 35.46%、29.16%、26.83%，收入及毛利贡献占比较高。公司对富士康销售收入波动具有真实合理原因，非因公司产品竞争力不足导致供应份额下降或者双方合作关系恶化。2025 年公司在对富士康销售减少的情况下，整体收入仍实现稳步增长，业务发展具备较强韧性，对富士康不存在依赖。

公司自 2008 年起与富士康开展合作，合作业务覆盖电子胶粘剂、电子焊接材料、湿化学品、自动化设备，终端应用涉及多个领域。2015 年富士康通过其下属全资投资平台金机虎投资入股公司，目前金机虎投资持有公司 3.44% 比例股份，双方业务合作未因金机虎投资入股而发生重大变化。报告期内，公司对富士康收入、毛利贡献占比下降，但富士康仍为公司第一大客户，若未来富士康及其终端客户采购需求下降、终端产品材料或制造工艺发生重大变化、富士康调整供应商体系，或公司产品不能持续满足其技术、质量及交付要求，导致供应份额下降或合作关系发生重大不利变化，可能导致富士康对公司产品需求减少，进而影响公司对富士康销售的稳定性。

5、下游应用领域需求波动的风险

报告期内，公司产品主要应用于智能终端领域，同时在通信、新能源、半导体等领域的应用上亦实现较好拓展。

公司营业收入的增长与下游行业的市场需求、终端应用产品销量等因素密切相关。近年来，由于宏观经济波动以及行业周期等因素的影响，包括智能终端等下游应用领域需求存在一定的波动。以智能手机为例，IDC 数据显示 2022-2024

年全球智能手机出货量分别为 12.04 亿台、11.63 亿台、12.40 亿台，变动幅度分别为-11.34%、-3.41%、6.62%。若未来下游应用领域的市场需求出现下降或终端应用产品的销量不及预期，将对公司经营业绩产生不利影响。

6、原材料价格波动的风险

报告期内，公司直接材料占主营业务成本的比例超过 85%，占比较高。公司采购的原材料主要包括用于生产电子焊接材料的锡锭、银，生产电子胶粘剂的填料、DMC，生产湿化学品的溶剂、活性剂，生产自动化设备的配件等。

受宏观经济环境及市场供需关系的影响，报告期内锡锭、银等大宗原材料价格持续上涨，公司通过开展期货套期保值业务等减少原材料价格波动对经营业绩的不利影响，但仍无法完全规避原材料价格大幅波动的风险。若原材料市场价格发生对公司不利的剧烈波动，而公司管理层无法准确判断价格趋势并及时采取有利措施，则公司经营业绩将受到一定不利影响。

7、毛利率波动的风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 31.55%、27.43%、27.03%，呈现一定波动性。公司电子胶粘剂、电子焊接材料、湿化学品、自动化设备业务在成本结构、产品结构、定价方式、客户需求等方面存在差异，各业务毛利率的主要影响因素亦有所不同。

电子胶粘剂业务方面，报告期内毛利率分别为 42.41%、41.09%、37.22%，整体有所下降。该业务毛利率主要受原材料价格及应用领域、产品结构变化影响。2025 年毛利率下降主要系新能源动力电池领域聚氨酯胶销售占比增加所致，该类产品用量较大但毛利率相对较低。若未来新能源动力电池、光伏及储能等相对低毛利率领域销售占比进一步提高，或原材料价格上涨、市场竞争加剧等导致产品价格下降，可能导致电子胶粘剂业务毛利率下降。

电子焊接材料业务方面，报告期内毛利率分别为 21.11%、17.03%、19.23%。该业务直接材料成本占比超过 90%，主要受锡锭、银等大宗金属价格影响。产品售价通常根据原材料价格调整，但部分客户按月度、季度或不定期调价，成本上涨与售价调整之间可能存在一定时间差。若未来锡锭、银等价格短期剧烈波动且未能及时向下游传导，可能导致电子焊接材料业务毛利率下降。

湿化学品业务方面，报告期内毛利率分别为 37.74%、27.46%、28.12%。2024 年毛利率下降，主要系表面处理剂产品降价，以及低毛利率的切削液、保护油墨等产品销售占比提高所致。该业务客户及应用领域相对集中，终端产品材质和加工工艺变化会影响不同产品的需求结构。若未来客户采购价格下降、低毛利率产品占比提高，或终端材质及工艺变化导致高毛利率产品需求下降，可能导致湿化学品业务毛利率下降。

自动化设备业务方面，报告期内毛利率分别为 25.13%、40.01%、40.14%，剔除收购厦门特盈评估增值影响后分别为 30.97%、41.35%、41.22%。该业务以定制化设备为主，不同项目在技术难度、订单规模、竞争程度、成本投入等方面差异较大。若未来低附加值项目占比提高、客户招投标价格下降，或项目调试改造导致成本增加，可能导致自动化设备业务毛利率下降。

综上，若未来产品及应用领域结构变化、原材料价格大幅波动、客户采购价格下降、市场竞争加剧、设备项目结构发生不利变化等，公司各业务毛利率及综合毛利率可能进一步波动或下降，并对盈利能力产生不利影响。

二、发行人本次发行情况

股票种类	人民币普通股（A 股）		
每股面值	1.00 元		
发行股数	不超过 2,666.67 万股	占发行后总股本比例	不低于 25%
其中：发行新股数量	不超过 2,666.67 万股	占发行后总股本比例	不低于 25%
股东公开发售股份数量	-	占发行后总股本比例	-
发行后总股本	不超过 10,666.67 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）		
每股发行价格	【】元		
发行市盈率	【】倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算）		
发行前每股净资产	【】元	发行前每股收益	【】元
发行后每股净资产	【】元	发行后每股收益	【】元
发行市净率	【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）		
发行方式	采用向战略投资者定向配售、或网下向符合条件的投资者询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式、或证券监管部门认可的其他发行方式		

发行对象	符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立深圳证券交易所股票账户并开通创业板交易的境内自然人、法人等创业板市场投资者，但法律、法规及深圳证券交易所业务规则等禁止参与者除外
承销方式	余额包销
拟公开发售股份股东名称	无
发行费用的分摊原则	不适用
募集资金总额	【】万元
募集资金净额	【】万元
募集资金投资项目	半导体及新能源专用材料项目
	研发中心建设项目
	补充流动资金
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元，包括：保荐费及承销费【】万元、审计及验资费【】万元、评估费【】万元、律师费【】万元、发行手续费【】万元

三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况

（一）保荐代表人

申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为东莞优邦材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，指派具体负责推荐的保荐代表人为吴隆泰和盛培锋。

保荐代表人吴隆泰的保荐业务执业情况：吴隆泰，申万宏源承销保荐业务董事，保荐代表人，具有注册会计师资格，中山大学金融硕士，中山大学经济学学士。吴隆泰 2016 年开始从事投资银行业务工作，主要项目经历包括：维峰电子（301328.SZ）IPO 项目、必易微（688045.SH）IPO 项目、共创草坪（605099.SH）IPO 项目、创世纪（300083.SZ）向特定对象发行股份项目、深圳资本集团战略入股中集集团（000039.SZ）项目、河南信产投收购华为超聚变项目、TCL 家电收购奥马电器（002668.SZ）项目、TCL 集团（000100.SZ）重大资产出售项目、TCL 科技（000100.SZ）发行股份购买少数股权项目、华侨城文旅公司债项目等。吴隆泰最近 12 个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施，最近 36 个月内未受到中国证监会的行政处罚。目前未签署其他已申报在审企业。

保荐代表人盛培锋的保荐业务执业情况：盛培锋，申万宏源承销保荐执行董

事，保荐代表人，具有注册会计师资格，华中科技大学管理学硕士，厦门大学管理学学士。盛培锋 2010 年开始从事投资银行业务工作，主要项目经历包括：维峰电子（301328.SZ）IPO 项目、电连技术（300679.SZ）IPO 项目、蒙娜丽莎（002918.SZ）IPO 项目、环球印务（002799.SZ）IPO 项目、创意信息（300366.SZ）并购重组项目、科达制造（600499.SH）非公开发行项目、蒙娜丽莎（002918.SZ）公开发行可转债项目，盛培锋最近 12 个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施，最近 36 个月内未受到中国证监会的行政处罚。目前未签署其他已申报在审企业。

（二）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

1、项目协办人

本次证券发行项目协办人为钟柱强。

项目协办人钟柱强的保荐业务执业情况：钟柱强，申万宏源承销保荐副总裁，英国诺丁汉大学金融硕士。钟柱强先生曾在毕马威从事审计和财务尽职调查工作多年，拥有丰富的财务经验，主要项目经历包括：徐福记集团和维他奶审计、沃特沃德 IPO 审计、卓尔集团收购中农网重大收购审计、科通芯城审计等项目现场负责人。作为投行核心成员参与的项目包括明阳电气 IPO、新明珠集团 IPO、维峰电子 IPO、华强电子网 IPO、奥马电器收购合肥家电等。

2、项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员为：唐柯尧、罗峻荣、常泮林、刘亭、徐前龙。

四、保荐人是否存在可能影响其及其保荐代表人公正履行保荐职责的情形的说明

经核查，截至本上市保荐书签署日，发行人与保荐人之间不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：

1、保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

3、保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方任职的情况；

4、保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

5、保荐人与发行人之间的其他关联关系。

五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项

（一）保荐人承诺已按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

保荐人同意推荐东莞优邦材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，相关结论具备相应的保荐工作底稿支持。

（二）保荐人承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所对推荐证券上市的相关规定，自愿接受深圳证券交易所的自律监管。

六、保荐人按照有关规定应当说明的事项

（一）发行人已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序

1、2025年11月27日，发行人召开第四届董事会第三次会议，审议并通过了关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的相关议案。

2、2025年12月12日，发行人召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的相关议案。

（二）发行人符合创业板定位及国家产业政策所作出的专业判断的说明

经核查，保荐人认为发行人符合创业板定位及国家产业政策：

1、公司创新性的核查情况

公司所处电子装联材料行业是电子信息制造业不可或缺的基础，下游应用领域包括智能终端、通信、新能源、半导体等，属于国家重点扶持和发展的战略性

新兴产业中的新材料产业，是保障国家电子信息产业链自主可控的关键材料。公司符合国家新质生产力发展需求，在电子胶粘剂、电子焊接材料、湿化学品、自动化设备等核心产品上实现了新产品研发、技术升级、配方创新、工艺优化、产品迭代和智能化生产，促进科技成果高水平应用，持续满足下游智能终端、通信、新能源、半导体等战略性新兴产业技术创新对高性能材料和新工艺方案的应用需求，推动下游行业新质生产力发展。

公司是国内电子装联材料领先企业之一，凭借突出的产品和技术实力，以及优秀的研发创新能力，被评为国家级高新技术企业、广东省专精特新中小企业、东莞市创新百强企业，公司研发中心获评广东省电子胶粘剂（优邦）工程技术研究中心；公司子公司苏州优诺被评为国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，苏州优诺研发中心获评江苏省电子封装材料及可靠性工程技术研究中心。公司通过多年不断的研发和持续创新，已掌握多项核心技术，均来源于自主研发创新，并已广泛应用于公司主营业务产品中。截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有已授权专利 104 项，其中发明专利 57 项。

在技术创新方面，经过多年研发投入，公司掌握了多项电子装联材料核心技术，包括关键原料设计合成技术、配方设计及生产工艺控制技术、特种工艺设备设计技术、产品检测及验证技术等，并建立了较全的材料数据库，拥有深厚的技术储备，形成公司的技术优势。

在产品创新方面，公司紧密跟踪下游产业向精细化、高可靠性、绿色环保方向发展的需求特征，根据客户工艺演进需求，开展定制化产品开发与迭代创新，成功研发系列高新技术产品，实现了产品品类与应用领域的不断拓展，在多个应用场景实现对标同类进口产品，推动电子装联材料国产化进程。

在模式创新方面，公司形成了独特的“产品+服务”整体解决方案模式，实现从单一产品供应向价值共创的转变，同时立足“材料+设备”产品战略，构建了“材料、设备、应用工艺”三位一体解决方案，实现从单一材料供应向“制造效率提升伙伴”的转型。

在推动新旧产业融合方面，公司紧跟行业发展趋势，通过新材料与新业态的交叉创新，成功将传统电子材料技术与新一代信息技术、新能源、半导体等战略

性新兴产业深度融合，不仅推动了公司产品结构优化升级，更为下游产业的技术创新和产品迭代提供了关键材料支撑。

综上，发行人深入贯彻创新驱动发展战略，具有创新、创造、创意特征，并支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合，符合《创业板暂行规定》第二条关于创业板定位的相关规定。

2、公司成长性的核查情况

公司是国内电子装联材料领先企业之一，自设立以来始终深耕电子装联材料行业，通过持续的技术研发、经验积累和市场开拓，公司建立了丰富的产品矩阵、完善的生产、研发和销售服务体系，形成了良好的行业口碑。公司与富士康、台达集团、和硕集团、群光电能、奇宏科技、明纬电子、立讯精密、亿纬锂能等行业知名企业建立了稳定的合作关系，产品最终服务于索尼、惠普、戴尔、亚马逊、中兴通讯、小鹏汽车等国内外知名终端品牌客户。公司以有机硅胶、锡膏为代表的多款产品性能及可靠性获得相应领域知名客户的认可并进入其供应链体系，正逐步推动类似产品国产化进程。

报告期内，公司实现营业收入金额分别为 89,879.23 万元、102,459.82 万元、113,568.72 万元，实现扣非后归属于母公司股东的净利润金额分别为 9,088.38 万元、9,182.02 万元、9,984.00 万元，公司营业收入和净利润均保持稳定增长，资产质量良好，财务状况稳健，具备较强的持续经营能力。

3、公司符合创业板行业领域的核查情况

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C398 电子元件及电子专用材料制造”之“C3985 电子专用材料制造”。公司所处行业不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第五条规定的行业，不属于产能过剩行业或《产业结构调整指导目录》中的淘汰类行业，亦不属于学前教育、学科类培训、类金融业务的企业。

4、公司符合创业板定位相关指标的核查情况

根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》：“第四条 本所支持和鼓励符合下列标准之一的成长型创新创业企业申

报在创业板发行上市：（一）最近三年研发投入复合增长率不低于 15%，最近一年投入金额不低于 1,000 万元，且最近三年营业收入复合增长率不低于 25%；（二）最近三年累计研发投入金额不低于 5,000 万元，且最近三年营业收入复合增长率不低于 25%；（三）属于制造业优化升级、现代服务业或者数字经济等现代产业体系领域，且最近三年营业收入复合增长率不低于 30%。最近一年营业收入金额达到 3 亿元的企业，或者按照《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》等相关规则申报创业板的已境外上市红筹企业，不适用前款规定的营业收入复合增长率要求。”

公司最近三年研发投入金额分别为 3,732.47 万元、4,393.56 万元、5,092.66 万元，最近三年累计研发投入金额不低于 5,000 万元；最近三年营业收入分别为 89,879.23 万元、102,459.82 万元、113,568.72 万元，最近一年营业收入金额达到 3 亿元，符合创业板支持和鼓励的成长型创新创业企业标准。

综上，发行人符合创业板定位。

（三）发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件的说明

保荐人依据《上市规则》相关规定，对发行人是否符合《上市规则》2.1.1 规定的上市条件进行了逐项核查，具体核查意见如下：

- 1、发行人符合中国证监会规定的创业板发行条件；
- 2、符合发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元；

发行人本次发行前股本总额为 8,000.00 万元，本次拟公开发行不超过 2,666.67 万股，发行后总股本不超过 10,666.67 万元，不低于人民币 3,000 万元。

- 3、符合公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；

发行人本次发行前股本总额为 8,000.00 万元，本次拟公开发行不超过 2,666.67 万股，公开发行的股份不低于发行后股份总数的 25%。

- 4、市值及财务指标符合《上市规则》规定的标准；

发行人最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不低于 6,000 万元，符合《上市规则》2.1.2 第一项规定的上市标准。

5、符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。

综上，保荐人认为，发行人符合《上市规则》规定的上市条件。

七、保荐人对发行人持续督导工作的安排

事项	安排
(一) 持续督导事项	在股票上市当年剩余时间以及其后3个完整会计年度内对发行人进行持续督导
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度	强化发行人严格执行中国证监会和深圳证券交易所相关规定的意识，进一步完善各项管理制度和发行人的决策机制，协助发行人执行相关制度；通过《保荐协议》约定确保保荐人对发行人关联交易事项的知情权，与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
2、督导发行人有效执行并完善防止董事、监事、高管人员利用职务之便损害发行人利益的内部控制制度	督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	督导发行人按照《公司章程》《关联交易管理制度》等规定执行，对重大的关联交易本机构将按照公平、独立的原则发表意见
4、督导发行人履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件	与发行人建立经常性信息沟通机制，督促发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露的规定
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	督导发行人按照《上市公司募集资金监管规则》管理和使用募集资金；定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东会，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	督导发行人遵守《公司章程》《对外担保制度》以及中国证监会关于对外担保行为的相关规定
7、持续关注发行人经营环境和业务情况、股权变动情况、管理层重大变化情况、采购和销售变化情况、核心技术变化情况以及财务状况	与发行人建立经常性信息沟通机制，及时获取发行人的相关信息
8、根据监管规定，对发行人进行定期及不定期现场检查	定期或者不定期对发行人进行回访，查阅所需的相关材料并进行实地专项核查
(二) 发行人应当积极配合保荐人履行持续督导职责	发行人已在保荐协议中承诺保障本机构享有履行持续督导职责相关的充分的知情权和查阅权，为保荐工作提供必要的条件和便利

八、保荐人认为应当说明的其他事项

截至本上市保荐书签署日，发行人不存在其他对本次证券发行上市有重大影响的事项。

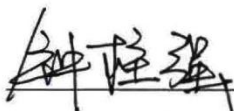
九、推荐结论

东莞优邦材料科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，发行人股票具备在创业板上市的条件。保荐人同意推荐东莞优邦材料科技股份有限公司的股票上市交易。

（以下无正文）

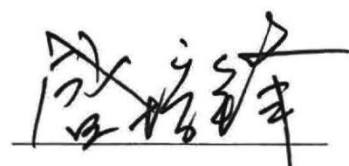
（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于东莞优邦材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签章页）

项目协办人：

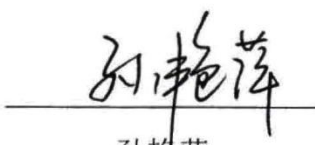

钟柱强

保荐代表人：


吴隆泰


盛培锋

内核负责人：


孙艳萍

保荐业务负责人、法定代表人：


王明希

保荐人（盖章）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2026 年 8 月 13 日